

2023-2027年中国芯片行业投资前景预测报告

产品名称	2023-2027年中国芯片行业投资前景预测报告
公司名称	北京华商纵横信息咨询中心
价格	6000.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区亚运村四方大厦
联系电话	188-11718743 13621060192

产品详情

章 芯片行业的总体概述

1.1 相关概念

1.1.1 芯片的内涵

1.1.2 集成电路的内涵

1.1.3 两者的联系与区别

1.2 常见类型

1.2.1 LED芯片

1.2.2 手机芯片

1.2.3 电脑芯片

1.2.4 大脑芯片

1.2.5 生物芯片

1.3 制作过程

1.3.1 原料晶圆

1.3.2 晶圆涂膜

1.3.3 光刻显影

1.3.4 掺杂杂质

1.3.5 晶圆测试

1.3.6 芯片封装

1.3.7 测试包装

1.4 芯片上下游产业链分析

1.4.1 产业链结构

1.4.2 上下游企业

第二章 2021-2023年全球芯片产业发展分析

2.1 2021-2023年世界芯片市场综述

2.1.1 市场发展历程

2.1.2 芯片生产周期

2.1.3 芯片资本支出

2.1.4 芯片供需现状

2.1.5 市场竞争格局

2.1.6 芯片设计现状

2.1.7 芯片制造产能

2.1.8 产业发展趋势

2.1.9 市场规模预测

2.2 美国芯片产业分析

2.2.1 产业发展优势

2.2.2 产业发展特点

2.2.3 产业发展历程

2.2.4 行业地位分析

2.2.5 政策布局加快

2.2.6 产业发展规模

2.2.7 研发支出规模

2.2.8 企业布局动态

2.2.9 机构发展动态

2.2.10 产业战略合作

2.2.11 芯片法案影响

2.3 日本芯片产业分析

2.3.1 产业发展特点

2.3.2 产业发展历程

2.3.3 政府扶持政策

2.3.4 市场发展规模

2.3.5 芯片企业排名

2.3.6 企业经营状况

2.3.7 企业收购动态

2.3.8 产业发展启示

2.4 韩国芯片产业分析

2.4.1 产业发展阶段

2.4.2 政府扶持政策

2.4.3 行业发展地位

2.4.4 芯片供应情况

2.4.5 芯片出口现状

2.4.6 市场竞争格局

2.4.7 芯片投资情况

2.4.8 产业发展经验

2.4.9 市场发展战略

2.5 印度芯片产业分析

2.5.1 产业发展优势

2.5.2 行业政策支持

2.5.3 行业发展现状

2.5.4 国际合作动态

2.5.5 产业发展挑战

2.5.6 芯片发展战略

2.6 中国台湾芯片产业分析

2.6.1 台湾芯片行业地位

2.6.2 台湾芯片激励政策

2.6.3 台湾芯片产业产值

2.6.4 台湾芯片竞争格局

2.6.5 重点企业投资动态

2.6.6 重点企业发展规划

第三章 2021-2023年中国芯片产业发展环境分析

3.1 经济环境

3.1.1 国内宏观经济

3.1.2 工业运行情况

3.1.3 固定资产投资

3.1.4 对外经济分析

3.1.5 宏观经济展望

3.2 社会环境

3.2.1 互联网加速发展

3.2.2 信息化发展水平

3.2.3 电子信息制造情况

3.2.4 研发经费投入增长

3.2.5 科技人才队伍壮大

3.2.6 万物互联带来需求

3.2.7 中美贸易战影响

3.3 技术环境

3.3.1 芯片技术研发进展

3.3.2 5G技术助力产业分析

3.3.3 后摩尔时代颠覆性技术

3.3.4 芯片技术发展方向分析

3.4 专利环境

3.4.1 专利申请数量变化

3.4.2 专利申请技术构成

3.4.3 专利申请省市分布

3.4.4 专利申请人排行

3.4.5 技术创新热点分析

3.5 产业环境

3.5.1 半导体产业链条

3.5.2 半导体材料市场

3.5.3 半导体设备市场

3.5.4 半导体资本开支

3.5.5 半导体销售规模

3.5.6 半导体产品结构

3.5.7 半导体竞争格局

3.5.8 半导体发展借鉴

第四章 2021-2023年中国芯片产业发展分析

4.1 2021-2023年中国芯片产业发展状况

4.1.1 行业发展历程

4.1.2 行业特点概述

4.1.3 产业发展背景

4.1.4 产业发展意义

4.1.5 市场销售收入

4.1.6 产业结构分析

4.1.7 下游应用分析

4.1.8 芯片产量状况

4.1.9 市场贸易状况

4.2 2021-2023年中国芯片市场格局分析

4.2.1 芯片企业数量

4.2.2 企业区域分布

4.2.3 企业竞争格局

4.2.4 城市发展格局

4.2.5 行业竞争分析

4.3 2021-2023年中国芯片国产化进程分析

4.3.1 核心芯片自给率低

4.3.2 产品研发制造短板

4.3.3 芯片国产化率分析

4.3.4 芯片国产化的进展

4.3.5 芯片国产化的问题

4.3.6 芯片国产化未来展望

4.4 中国芯片产业发展困境分析

4.4.1 国内外产业差距

4.4.2 芯片供应短缺

4.4.3 过度依赖进口

4.4.4 技术短板问题

4.4.5 人才短缺问题

4.4.6 市场发展不足

4.5 中国芯片产业应对策略分析

4.5.1 突破垄断策略

4.5.2 化解供给不足

4.5.3 加强自主创新

4.5.4 加大资源投入

4.5.5 人才培养策略

4.5.6 总体发展建议

第五章 2021-2023年中国重点地区芯片产业发展分析

5.1 广东省

5.1.1 产业支持政策

5.1.2 发展条件分析

5.1.3 产业发展现状

5.1.4 市场产量规模

5.1.5 城市发展现状

5.1.6 竞争格局分析

5.1.7 项目建设动态

5.1.8 产业发展问题

5.1.9 发展模式建议

5.1.10 发展机遇与挑战

5.1.11 产业发展规划

5.2 北京市

5.2.1 产业发展优势

5.2.2 产量规模状况

5.2.3 产业发展动态

5.2.4 典型产业园区

5.2.5 项目发展动态

5.2.6 产业发展困境

5.2.7 产业发展对策

5.2.8 产业发展规划

5.3 上海市

5.3.1 产业支持政策

5.3.2 市场规模分析

5.3.3 产量规模状况

5.3.4 产业空间布局

5.3.5 项目建设动态

5.3.6 产业发展规划

5.4 南京市

5.4.1 江苏芯片产业

5.4.2 产业发展优势

5.4.3 产业扶持政策

5.4.4 产业规模分析

5.4.5 产业创新体系

5.4.6 项目发展动态

5.4.7 典型产业园区

5.4.8 产业发展方向

5.4.9 产业发展规划

5.5 厦门市

5.5.1 福建芯片产业

5.5.2 产业扶持政策

5.5.3 产业发展实力

5.5.4 产业规模分析

5.5.5 区域发展格局

5.5.6 项目投资动态

5.5.7 产业发展规划

5.6 杭州市

5.6.1 浙江芯片产业

5.6.2 产业支持政策

5.6.3 产业发展载体

5.6.4 产业营收规模

5.6.5 企业布局情况

5.6.6 项目发展动态

5.7 其他城市

5.7.1 武汉市

5.7.2 西安市

5.7.3 合肥市

5.7.4 重庆市

5.7.5 无锡市

5.7.6 天津市

5.7.7 晋江市

第六章 2021-2023年中国芯片设计及制造发展分析

6.1 2021-2023年中国芯片设计行业发展分析

6.1.1 芯片设计概述

6.1.2 市场发展规模

6.1.3 企业数量规模

6.1.4 产业区域竞争

6.1.5 产品领域分布

6.1.6 设计人员需求

6.1.7 企业融资动态

6.1.8 行业发展困境

6.1.9 行业壁垒分析

6.1.10 未来发展趋势

6.2 2021-2023年中国晶圆代工产业发展分析

6.2.1 晶圆制造工艺

6.2.2 行业发展规模

6.2.3 行业竞争格局

6.2.4 行业区域分布

6.2.5 应用领域分析

6.2.6 工艺制程进展

6.2.7 企业经营状况

6.2.8 行业壁垒分析

6.2.9 行业发展前景

第七章 2021-2023年中国芯片封装测试市场发展分析

7.1 中国芯片封装测试行业发展综况

7.1.1 封装技术介绍

7.1.2 芯片测试原理

7.1.3 主要测试分类

7.1.4 测试准备规划

7.1.5 发展面临的问题

7.2 中国芯片封装测试市场分析

7.2.1 全球市场状况

7.2.2 全球竞争格局

7.2.3 规模

7.2.4 技术水平分析

7.2.5 国内企业排名

7.2.6 企业布局情况

7.2.7 企业收购动态

7.2.8 产业融资情况

7.3 中国芯片封测行业发展前景及趋势分析

7.3.1 行业发展机遇

7.3.2 行业发展前景

7.3.3 市场发展前景

7.3.4 技术发展趋势

7.3.5 产业趋势分析

7.3.6 产业发展方向

第八章 2021-2023年中国芯片产业应用市场分析

8.1 LED领域

8.1.1 产业发展状况

8.1.2 LED芯片规模

8.1.3 行业产能分析

8.1.4 行业区域分布

8.1.5 企业业务布局

8.1.6 企业竞争格局

8.1.7 市场竞争模型

8.1.8 项目建设动态

8.1.9 封装技术难点

8.1.10 行业发展趋势

8.2 物联网领域

8.2.1 产业链的地位

8.2.2 产业发展关键

8.2.3 行业相关政策

8.2.4 市场驱动因素

8.2.5 行业竞争格局

8.2.6 竞争主体分析

8.2.7 物联网连接芯片

8.2.8 典型应用产品

8.2.9 企业投资动态

8.2.10 产业发展趋势

8.2.11 市场规模预测

8.3 无人机领域

8.3.1 无人机产业链

8.3.2 市场规模状况

8.3.3 注册规模情况

8.3.4 市场占比情况

8.3.5 市场竞争格局

8.3.6 主流解决方案

8.3.7 芯片应用领域

8.3.8 市场前景趋势

8.4 卫星导航领域

8.4.1 北斗芯片概述

8.4.2 产业发展状况

8.4.3 芯片销量状况

8.4.4 企业竞争格局

8.4.5 芯片应用分析

8.4.6 融资合作动态

8.4.7 产业发展趋势

8.5 智能穿戴领域

8.5.1 产业链构成

8.5.2 产品类别分析

8.5.3 市场规模状况

8.5.4 市场竞争格局

8.5.5 芯片研发动态

8.5.6 芯片厂商对比

8.5.7 发展潜力分析

8.5.8 行业未来态势

8.6 智能手机领域

8.6.1 出货规模分析

8.6.2 产业发展现状

8.6.3 智能手机芯片

8.6.4 芯片销量情况

8.6.5 企业竞争格局

8.6.6 产品技术路线

8.6.7 芯片评测状况

8.6.8 芯片评测方案

8.6.9 芯片研制进程

8.7 汽车电子领域

8.7.1 行业发展状况

8.7.2 市场规模状况

8.7.3 车用芯片格局

8.7.4 车用芯片研发

8.7.5 车用芯片项目

8.7.6 企业战略合作

8.7.7 行业投融资情况

8.7.8 智能驾驶应用

8.7.9 未来发展前景

8.8 生物医药领域

8.8.1 生物芯片介绍

8.8.2 市场政策环境

8.8.3 行业产业链条

8.8.4 行业应用领域

8.8.5 企业数量规模

8.8.6 重点企业分析

8.8.7 行业专利数量

8.8.8 行业发展挑战

8.8.9 行业发展前景

8.8.10 行业发展趋势

8.9 通信领域

8.9.1 芯片应用状况

8.9.2 射频芯片需求

8.9.3 重点企业分析

8.9.4 5G芯片发展

8.9.5 企业发展动态

8.9.6 产品研发动态

第九章 2021-2023年创新型芯片产品发展分析

9.1 计算芯片

9.1.1 行业发展概况

9.1.2 技术发展关键

9.1.3 计算芯片测试

9.1.4 产品研发应用

9.1.5 企业融资动态

9.1.6 发展机遇分析

9.1.7 发展挑战分析

9.2 智能芯片

9.2.1 AI芯片基本概述

9.2.2 AI芯片政策机遇

9.2.3 AI芯片市场规模

9.2.4 AI芯片市场结构

9.2.5 AI芯片产业链条

9.2.6 AI芯片区域分布

9.2.7 AI芯片应用领域

9.2.8 AI芯片企业布局

9.2.9 AI芯片厂商融资

9.2.10 AI芯片发展前景

9.3 量子芯片

9.3.1 技术体系对比

9.3.2 市场发展形势

9.3.3 产品研发动态

9.3.4 关键技术突破

9.3.5 未来发展前景

9.4 低耗能芯片

9.4.1 产品发展背景

9.4.2 系统及结构优化

9.4.3 器件结构分析

9.4.4 低功耗芯片设计

9.4.5 产品研发进展

第十章 2021-2023年国际芯片重点企业经营状况分析

10.1 英伟达 (NVIDIA Corporation)

10.1.1 企业发展概况

10.1.2 2021财年企业经营状况分析

10.1.3 2022财年企业经营状况分析

10.1.4 2023财年企业经营状况分析

10.2 高通 (QUALCOMM, Inc.)

10.2.1 企业发展概况

10.2.2 2021财年企业经营状况分析

10.2.3 2022财年企业经营状况分析

10.2.4 2023财年企业经营状况分析

10.3 台湾积体电路制造公司

10.3.1 企业发展概况

10.3.2 2021年企业经营状况分析

10.3.3 2022年企业经营状况分析

10.3.4 2023年企业经营状况分析

10.4 格芯

10.4.1 企业发展概况

10.4.2 企业合作动态

10.4.3 2021年企业经营状况分析

10.4.4 2022年企业经营状况分析

10.4.5 2023年企业经营状况分析

10.5 日月光半导体制造股份有限公司

10.5.1 企业发展概况

10.5.2 企业业务布局

10.5.3 2021年企业经营状况分析

10.5.4 2022年企业经营状况分析

10.5.5 2023年企业经营状况分析

第十一章 2020-2023年中国大陆重点企业经营状况分析

11.1 中芯国际集成电路制造有限公司

11.1.1 企业发展概况

11.1.2 经营效益分析

11.1.3 业务经营分析

11.1.4 财务状况分析

11.1.5 核心竞争力分析

11.1.6 公司发展战略

11.1.7 未来前景展望

11.2 江苏长电科技股份有限公司

11.2.1 企业发展概况

11.2.2 经营效益分析

11.2.3 业务经营分析

11.2.4 财务状况分析

11.2.5 核心竞争力分析

11.2.6 公司发展战略

11.2.7 未来前景展望

11.3 通富微电子股份有限公司

11.3.1 企业发展概况

11.3.2 经营效益分析

11.3.3 业务经营分析

11.3.4 财务状况分析

11.3.5 核心竞争力分析

11.3.6 公司发展战略

11.3.7 未来前景展望

11.4 天水华天科技股份有限公司

11.4.1 企业发展概况

11.4.2 经营效益分析

11.4.3 业务经营分析

11.4.4 财务状况分析

11.4.5 核心竞争力分析

11.4.6 公司发展战略

11.4.7 未来前景展望

11.5 紫光国芯微电子股份有限公司

11.5.1 企业发展概况

11.5.2 经营效益分析

11.5.3 业务经营分析

11.5.4 财务状况分析

11.5.5 核心竞争力分析

11.5.6 未来前景展望

第十二章 2021-2023年中国芯片行业投资分析

12.1 投资机遇分析

12.1.1 投资需求上升

12.1.2 国产化投资机会

12.1.3 产业链投资机遇

12.1.4 资本市场机遇

12.1.5 政府投资机遇

12.2 行业投资分析

12.2.1 市场融资规模

12.2.2 融资轮次分布

12.2.3 融资地域分布

12.2.4 融资赛道分析

12.2.5 投资机构分析

12.2.6 行业投资建议

12.3 基金融资分析

12.3.1 基金投资周期分析

12.3.2 基金投资情况分析

12.3.3 基金减持情况分析

12.3.4 基金投资策略分析

12.3.5 基金投资风险分析

12.3.6 基金未来规划方向

12.4 行业并购分析

12.4.1 全球产业并购现状

12.4.2 全球产业并购规模

12.4.3 国内产业并购特点

12.4.4 企业并购动态分析

12.4.5 产业并购策略分析

12.4.6 市场并购趋势分析

12.5 投资风险分析

12.5.1 行业投资壁垒

12.5.2 贸易政策风险

12.5.3 贸易合作风险

12.5.4 宏观经济风险

12.5.5 技术研发风险

12.5.6 环保相关风险

12.6 融资策略分析

12.6.1 项目包装融资

12.6.2 高新技术融资

12.6.3 BOT项目融资

12.6.4 IFC国际融资

12.6.5 专项资金融资

第十三章 中国芯片行业典型项目投资建设案例深度解析

13.1 物联网领域芯片研发升级及产业化项目

13.1.1 项目基本概况

13.1.2 项目的必要性

13.1.3 项目的可行性

13.1.4 项目投资概算

13.1.5 项目环保情况

13.2 MEMS和功率器件芯片制造及封装测试项目

13.2.1 项目基本概况

13.2.2 项目的必要性

13.2.3 项目的可行性

13.2.4 项目投资概算

13.2.5 项目环境保护

13.3 Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目

13.3.1 项目基本概况

13.3.2 项目的必要性

13.3.3 项目的可行性

13.3.4 项目投资概算

13.3.5 项目实施进度

13.3.6 项目投资效益

13.4 车载以太网芯片开发与产业化项目

13.4.1 项目基本概况

13.4.2 项目的必要性

13.4.3 项目投资概算

13.4.4 项目实施进度

13.4.5 项目环保情况

13.5 网通以太网芯片开发与产业化项目

13.5.1 项目基本概述

13.5.2 项目的必要性

13.5.3 项目投资概算

13.5.4 项目实施进度

13.5.5 项目环保情况

13.6 网络通信与计算芯片定制化解决方案平台项目

13.6.1 项目基本概况

13.6.2 项目的可行性

13.6.3 项目投资概算

13.6.4 项目实施进度

13.7 工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台项目

13.7.1 项目基本概况

13.7.2 项目的可行性

13.7.3 项目投资概算

13.7.4 项目实施进度

第十四章 2023-2027年中国芯片产业未来前景展望

14.1 中国芯片市场发展机遇分析

14.1.1 芯片产业发展机遇

14.1.2 芯片产业发展前景

14.1.3 芯片产业发展趋势

14.1.4 芯片技术研发方向

14.1.5 AI芯片未来发展前景

14.2 中国芯片产业细分领域前景展望

14.2.1 芯片材料

14.2.2 芯片设计

14.2.3 芯片制造

14.2.4 芯片封测

14.3 2023-2027年中国芯片行业预测分析

14.3.1 2023-2027年中国芯片行业影响因素分析

14.3.2 2023-2027年中国集成电路产量额预测

14.3.3 2023-2027年中国集成电路产业销售额预测

第十五章 中国芯片行业政策规划分析

15.1 产业标准体系

15.1.1 中国芯片政策发布历程

15.1.2 中国芯片行业政策汇总

15.1.3 芯片行业政策影响分析

15.2 财政扶持政策

15.2.1 进口税收支持政策

15.2.2 企业税收优惠政策

15.3 监管体系分析

15.3.1 行业监管部门

15.3.2 并购重组态势

15.3.3 产权保护政策

15.4 相关政策分析

15.4.1 智能制造政策

15.4.2 智能传感器政策

15.4.3 人工智能相关政策

15.4.4 电子元器件行动计划

15.4.5 半导体产业扶持政策

15.5 产业发展规划

15.5.1 发展思路

15.5.2 发展目标

15.5.3 发展重点

15.5.4 措施建议

15.6 地区发展政策

15.6.1 辽宁省集成电路产业发展政策

15.6.2 河北省集成电路产业发展规划

15.6.3 山东省集成电路产业发展规划

15.6.4 江苏省集成电路产业发展政策

15.6.5 浙江省集成电路产业发展政策

15.6.6 湖北省集成电路产业发展规划

15.6.7 甘肃省集成电路产业发展规划

15.6.8 江西省集成电路产业发展规划

图表目录

图表1 芯片的产业链结构

图表2 国内芯片产业链及主要厂商梳理

图表3 芯片技术发展的里程碑

图表4 芯片生产流程

图表5 芯片订货的等候时间

图表6 2000-2021全球芯片业销售与资本支出

图表7 2021年全球IC公司销售额市场份额

图表8 2021年专属晶圆代工排名

图表9 2018-2022年国内生产总值及其增长速度

图表10 2018-2022年三次产业增加值占国内生产总值比重

图表11 2023年GDP初步核算数据

图表12 2018-2023年GDP同比增长速度

图表13 2018-2023年GDP环比增长速度

图表14 2018-2022年全部工业增加值及其增长速度

图表15 2022年主要工业产品产量及其增长速度

图表16 2022-2023年规模以上工业增加值同比增长速度

图表17 2022年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重

图表18 2022年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度

图表19 2022年固定资产投资新增主要生产与运营能力

图表20 2022-2023年固定资产投资（不含农户）同比增速

图表21 2018-2022年货物进出口总额

图表22 2022年货物进出口总额及其增长速度

图表23 2022年主要商品出口数量、金额及其增长速度

图表24 2022年主要商品进口数量、金额及其增长速度

图表25 2022年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重

图表26 2022年外商直接投资及其增长速度

图表27 2022年对外非金融类直接投资额及其增长速度

图表28 2022-2023年电信业务收入和电信业务总量累计增速

图表29 2022-2023年新兴业务收入增长情况

图表30 2022-2023年100M速率以上、1000M速率以上的固定互联网宽带接入用户情况

图表31 2022-2023年5G移动电话用户情况

图表32 2022-2023年物联网终端用户情况

图表33 2022-2023年移动互联网累计接入流量及增速情况

图表34 2022-2023年移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况

图表35 2022-2023年移动电话用户增速和通话时长增速情况

图表36 2022-2023年移动短信业务量和收入同比增长情况

图表37 2022-2023年光缆线路总长度发展情况

图表38 2022-2023年互联网宽带接入端口数发展情况

图表39 2022-2023年电子信息制造业和工业增加值累计增速

图表40 2022-2023年电子信息制造业和工业出口交货值累计增速

图表41 2022-2023年电子信息制造业营业收入、利润总额累计增速

图表42 2022-2023年电子信息制造业和工业固定资产投资累计增速

图表43 芯片封装技术发展路径

图表44 2014-2023年芯片技术相关专利申请及授权分布图

图表45 2014-2023年芯片技术相关专利申请及授权分布表

图表46 截至2023年芯片技术相关专利技术类型分布

图表47 截至2023年芯片技术相关专利技术构成图

图表48 截至2023年芯片技术相关专利技术构成表

图表49 截至2023年芯片技术相关专利省市分布图

图表50 截至2023年芯片技术相关专利省市分布表

图表51 截至2023年芯片技术相关专利人排行

图表52 芯片技术创新热点

图表53 截至2023年机器人技术核心概念专利数量

图表54 半导体产业链

图表55 2017-2023年全球半导体材料市场规模变化